

2025年3月期 決算概況 及び 中期経営計画進捗状況

2025年5月30日
株式会社レスター

<将来の見通しに関する注意事項>

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略は将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績は、様々な外部要因、内部要因の変化により、これらの業績見通しとは異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動並びに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。本資料・データの無断転用はご遠慮ください。

<お問い合わせ先>
レスター 広報・IR室
E-mail: irpr@restargp.com

本日のAgenda

- 1** 2025年3月期 連結業績ハイライト
専務執行役員 二島 進
- 2** 中期経営計画全体進捗サマリ
総合企画本部長 榊原 琢人
- 3** デバイスBU／エンジニアリングBU
専務執行役員 柴田 真裕
- 4** システムBU
代表取締役専務 今野 宏晃
- 5** IT&SIerBU
PCIホールディングス株式会社 取締役 森下 健作
- 6** 質疑応答

1 2025年3月期 連結業績ハイライト

専務執行役員 二島 進

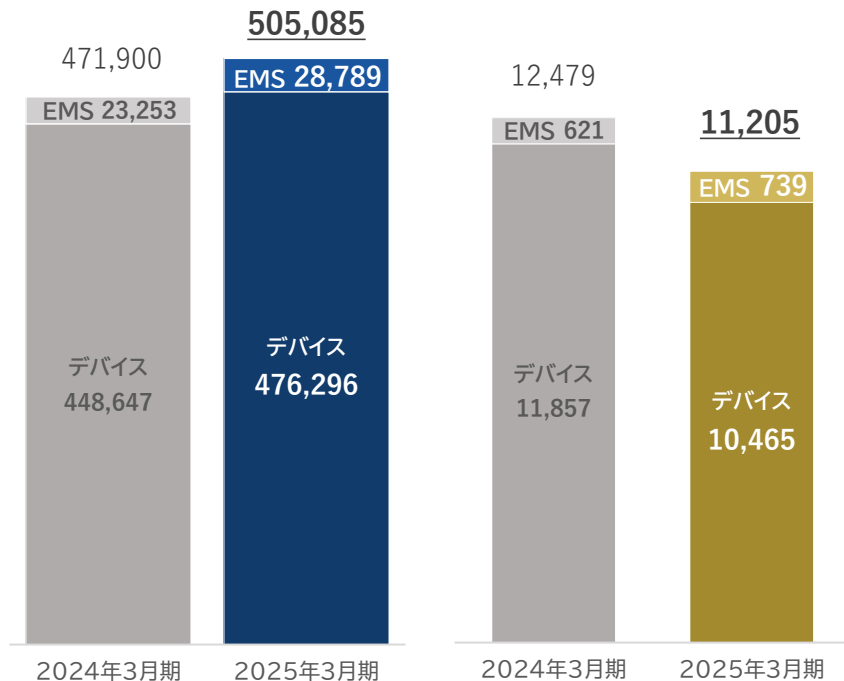
(単位:百万円)	2024年3月期 通期		2025年3月期 通期		前年同期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	増減率
売上高	512,484	—	561,001	—	48,517	9.5%
売上総利益	45,271	8.8%	47,700	8.5%	2,428	5.4%
販売管理費	29,340	5.7%	33,526	6.0%	4,185	14.3%
営業利益	15,931	3.1%	14,174	2.5%	△1,756	△11.0%
経常利益	9,690	1.9%	9,559	1.7%	△130	△1.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	7,004	1.4%	7,473	1.3%	468	6.7%

デバイスBU

売上高

セグメント利益

(単位:百万円)

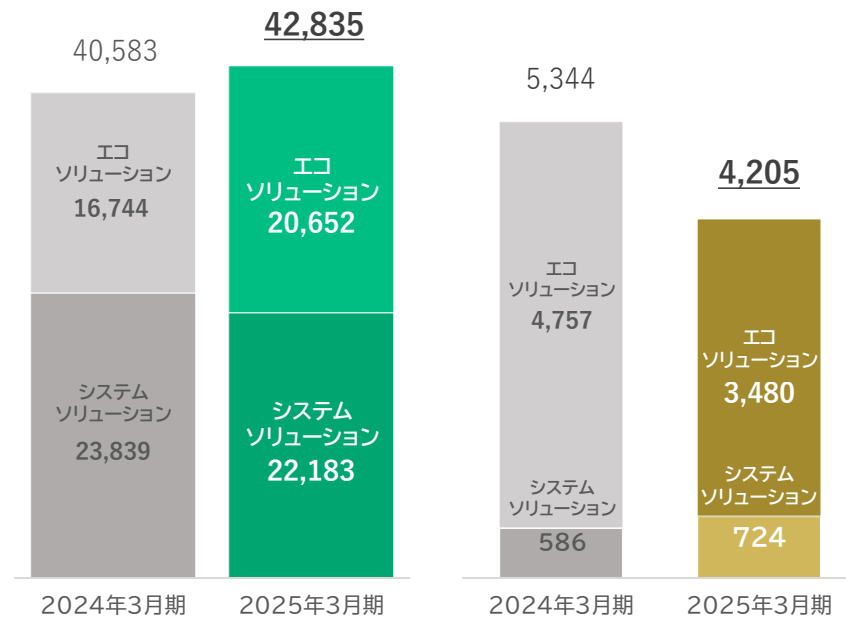


システムBU

売上高

セグメント利益

(単位:百万円)



- 2024年9月27日に中期経営計画の柱である4BU体制の新BU「IT & SIerBU」の基盤を担うPCIグループを連結子会社
- PCIグループの強みであるソフトウェア開発やソリューション開発・保守等の情報サービス事業を軸に、両社の強みを生かした技術リソースの強化並びに企画提案等の上流プロセスへの展開を加速させ、更なる市場の深耕・拡大を図る

売上高

13,079百万円

セグメント利益

468百万円

IT & SIer

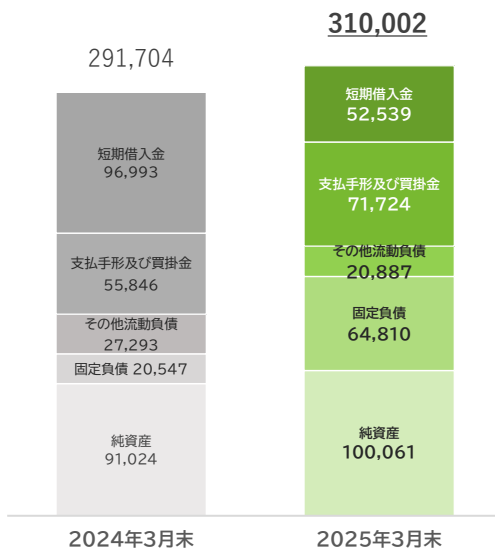
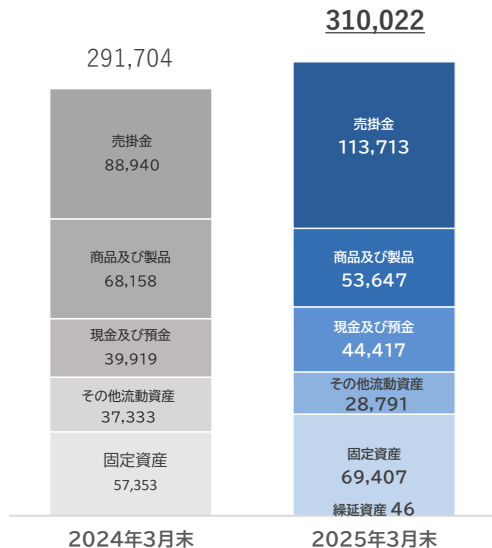
2024年9月27日にPCIグループを連結子会社として以降、サービス商品化を目的とした技術の棚卸を実施し。両グループ内での活用可能なサービス・商品を選定するなど、PCIグループの技術力を活用し、それぞれの顧客基盤を活かした新たな案件や領域に向けた販売活動を推進

連結貸借対照表

(単位:百万円)

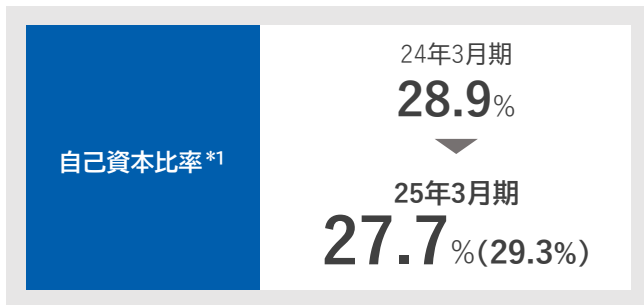
〈資産の部〉

〈負債・純資産の部〉

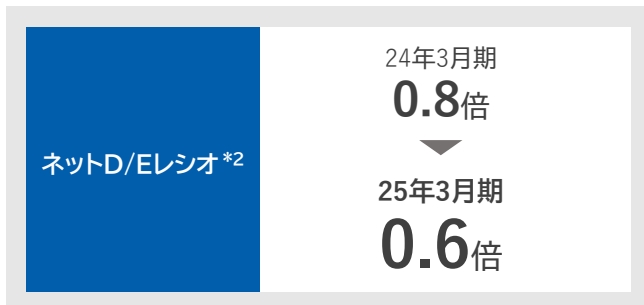


資産の部	増減要因
流動資産	売掛金 +24,773、現金及び預金 +4,497、商品及び製品 △14,510、その他流動資産 △6,642
固定資産	繰延税金資産 +5,846、貸倒引当金 △7,090

負債・純資産の部	増減要因
流動負債	支払手形及び買掛金 +15,878、短期借入金 △44,454
固定負債	長期借入金 +32,991、社債 +10,000
純資産	非支配株主持分 +7,417、利益剰余金 +6,459、自己株式 +5,388、為替換算調整勘定 +4,027、資本剰余金 △3,370



*1()内の数字は、ハイブリッドローン(劣後特約付きローン)を加味した格付上の数値
(2024年8月に調達したハイブリッドローン(劣後特約付きローン)100億円については格付上の資本性50%を考慮して計算)



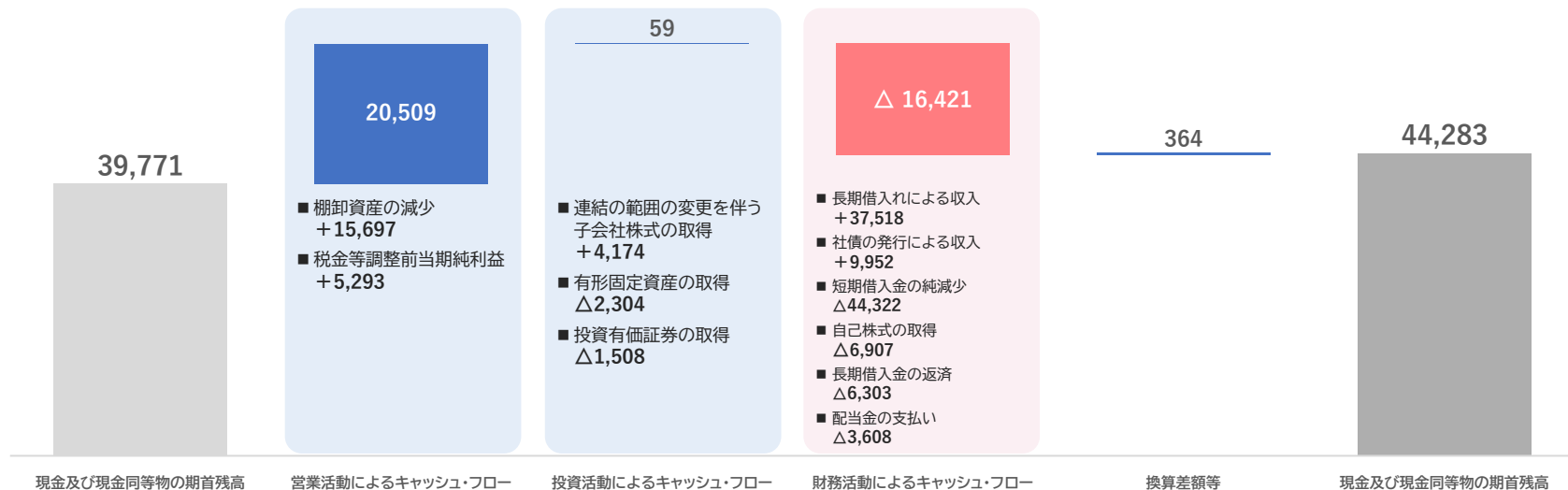
*2ネットD/Eレシオ=(リース債務を除く有利子負債-現金及び預金)÷自己資本

→安定的に1.2倍を下回る水準を維持

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2024年3月期	2025年3月期	増減額
現金及び現金同等物の期首残高	31,984	39,771	7,786
■ 営業活動によるキャッシュ・フロー	15,668	20,509	4,840
■ 投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,613	59	6,673
■ 財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,005	△16,421	△13,415
■ 換算差額等	1,437	364	△1,073
現金及び現金同等物の期末残高	39,771	44,283	4,512



(単位:百万円)	2025年3月期 通期実績	2026年3月期 通期見通し*	前期比
	金額	金額	
売上高	561,001	600,000	7.0%
営業利益	14,174	16,000	12.9%
経常利益	9,559	12,500	30.8%
親会社株主に帰属する 純利益	7,473	7,500	0.4%

*現時点においては、米国の各国への関税措置による当社業績への直接的な影響は軽微であると認識しております。
今後、開示すべき重大な影響が見込まれる場合には速やかに公表いたします。

ビジネスユニット別見通し

		2025年3月期 通期実績	2026年3月期 通期見通し	前期比	
(単位:百万円)		金額	金額	増減額	増減率
売上高	デバイスBU	505,085	530,200	25,114	5.0%
	デバイス	476,296	504,700	28,403	6.0%
	EMS	28,789	25,500	△3,289	△11.4%
	システムBU	42,835	42,000	△835	△2.0%
	システムソリューション	22,183	24,000	1,816	8.2%
	エコソリューション	20,652	18,000	△2,652	△12.8%
	IT&SIerBU	13,079	27,800	14,720	112.5%
	連結	561,001	600,000	38,998	7.0%
セグメント利益	デバイスBU	11,205	12,450	1,244	11.1%
	デバイス	10,465	12,000	1,534	14.7%
	EMS	739	450	△289	△39.2%
	システムBU	4,205	3,350	△855	△20.3%
	システムソリューション	724	650	△74	△10.3%
	エコソリューション	3,480	2,700	△780	△22.4%
	IT&SIerBU	468	1,950	1,481	316.4%
	全社・調整	△1,704	△1,750	△45	2.7%
連結		14,174	16,000	1,825	12.9%

*IT&SIerBUの前期比:売上高・セグメント利益ともに2024年10月から2025年3月までの実績との比較

株主還元方針

■ 2027年3月期を最終年度とする中期経営計画の期間の基本方針

- ・ 安定的な株主還元の充実、成長領域への積極的な投資と財務健全性のバランスを考慮
- ・ 連結株主資本配当率(DOE*)4%以上
- ・ 安定的且つ継続的に増配の実施
- ・ 余剰資金については機動的な自社株買い

*DOE(Dividend on Equity):株主資本配当率 = 配当額÷株主資本 = 配当利回×PBR

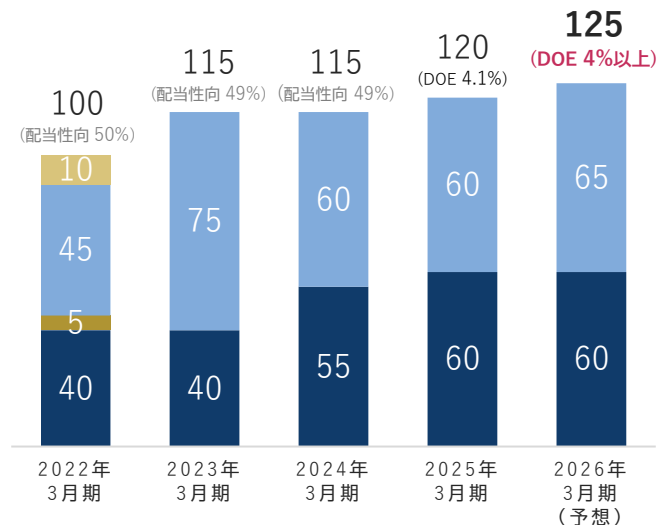
株主資本をベースとするため、配当性向に比べて、利益のブレに対する影響が少なく、安定的な配当となります。

当社は、株主の皆様安心して長期保有いただけるよう、DOEを重要な指標として捉えて、株主還元を行ってまいります。

1株当たり配当金

(単位:円)

■ 第2四半期 ■ 期末 ■ 記念配当・特別配当



2025年3月期 配当

第2四半期末

60 円

期末

60 円

合計

120 円

2026年3月期 配当予想

第2四半期末

60 円

期末

65 円

合計

125 円

2 中期経営計画 全体進捗サマリ

執行役員 榊原 琢人

中期経営計画の目標

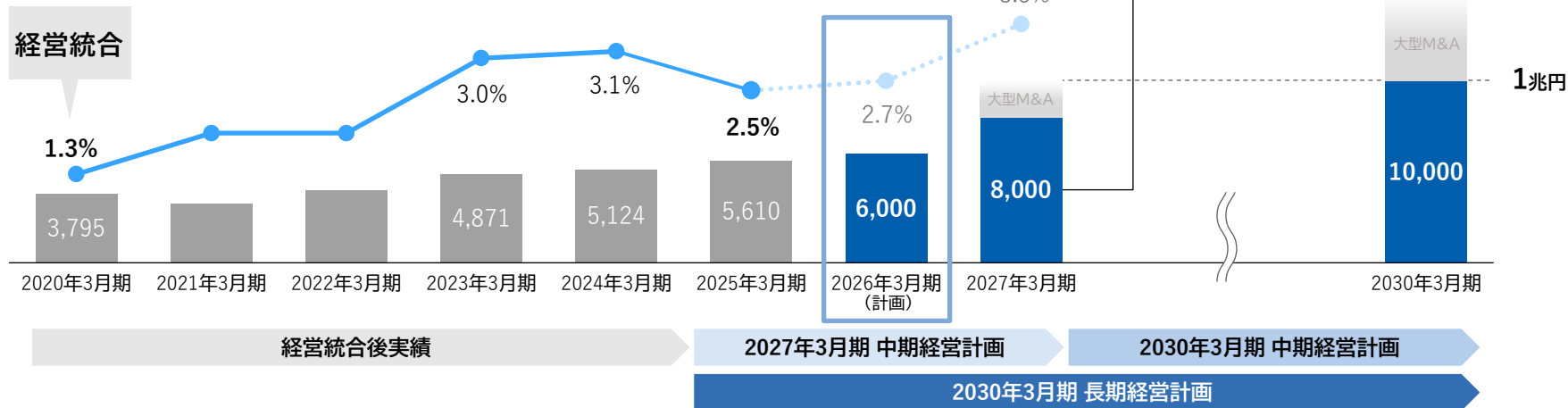
- 2027年3月期までの中期経営計画において、財務規律を維持しつつ既存事業のオーガニックな成長に加えて、新たな事業を追加し事業拡大図る
 - IT&SIerBUを立ち上げに成功も当初計画の規模感には更なるパートナー連携必要
 - エンジニアリングBUの立ち上げ時期見直し
- 収益構造変革の新規BU計画の見直しによる収益性KPI見直し

2027年3月期 目標

	売上高	営業利益率	ROE	ROIC
24年5月28日 開示目標	8,000億円	4%~	12%~	7%~
25年5月29日 開示目標	8,000億円	3.5%~	11%~	6%~

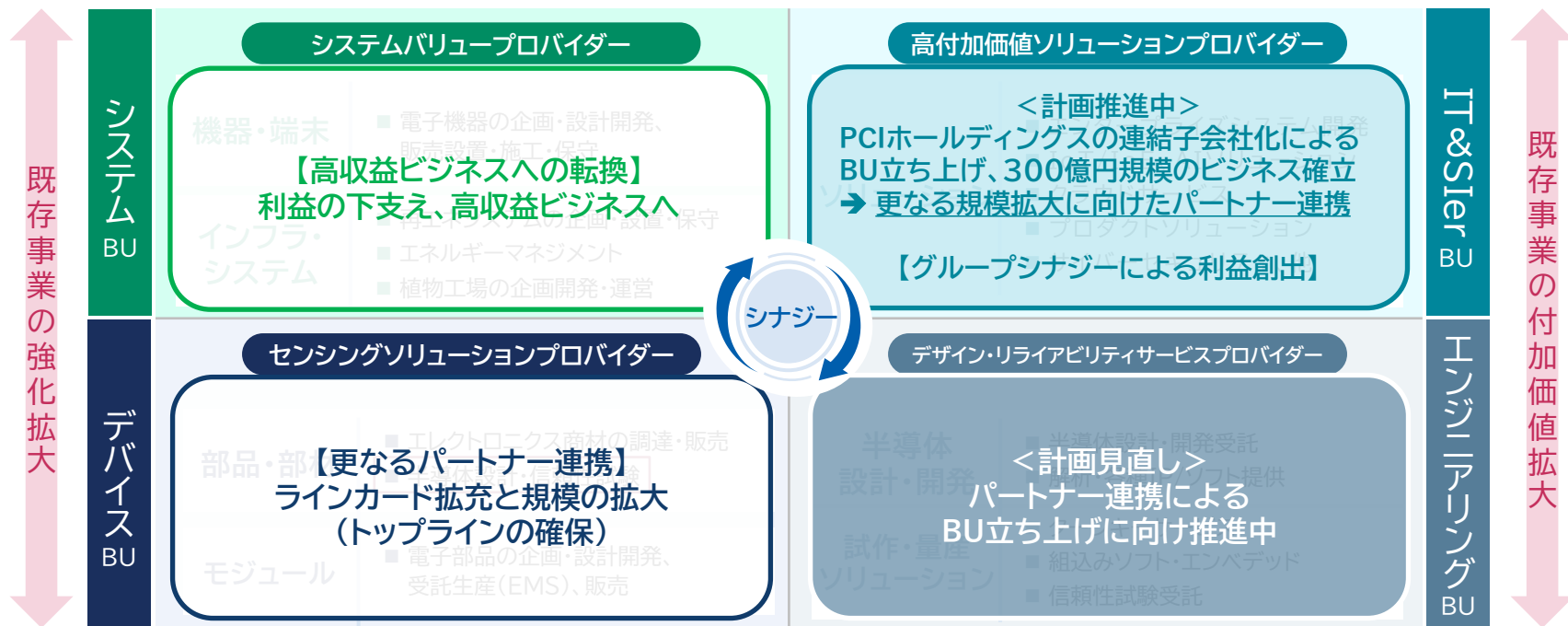
■ 売上高
■ 売上高(実績)
● 営業利益率

単位: 億円



中期経営計画で目指す4事業(4BU:ビジネスユニット)

- ・ 収益構造改革に向けて引き続き4BU体制の確立を目指し推進中
- ・ 半導体商社から、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたエレクトロニクスの情報のプラットフォーマーへの変革



DX推進による情報プラットフォームの整備

基幹システム

データ連携基盤

分析基盤

SFA(営業支援システム)

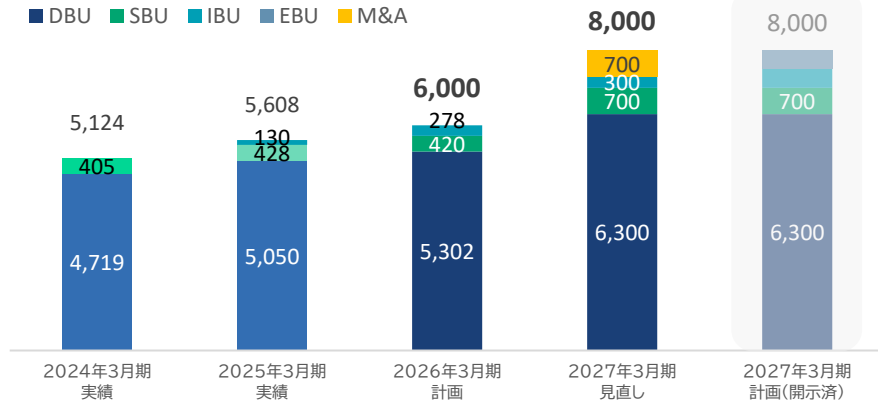
AI活用

中期経営計画見直し

売上高

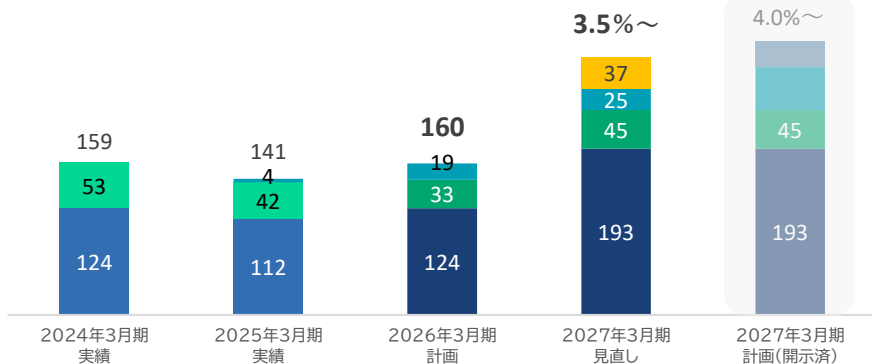
(単位:億円)

■ DBU ■ SBU ■ IBU ■ EBU ■ M&A



営業利益 (連結には全社コストを含む)

(単位:億円)



ポイント

デバイスBU

- 産機・車載・グローバルでの重要施策の推進
- パートナー連携によるクロスセル拡大と商流開発
- 根幹事業として規模拡大と収益性改善

システムBU

- システムソリューション事業における規模拡大
- エコソリューション事業における収益力拡大
- 規模拡大に向けたパートナー連携

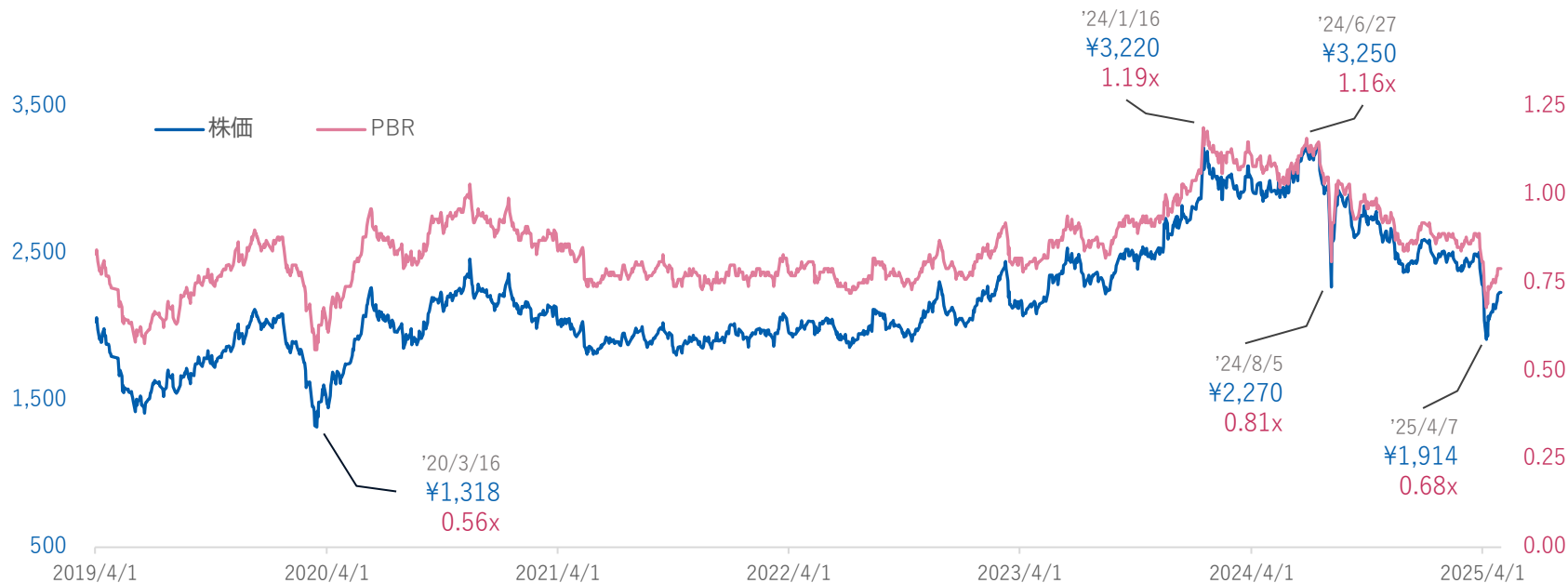
IT&SIerBU

- 計画通り新たなBU立ち上げも更なる規模追求
- グループ内シナジーの創出(システムBU連携)
- 収益力の最大化とグループ内連携による付加価値創出

M & A

- パートナー候補の精査と実行

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について【現状分析1】

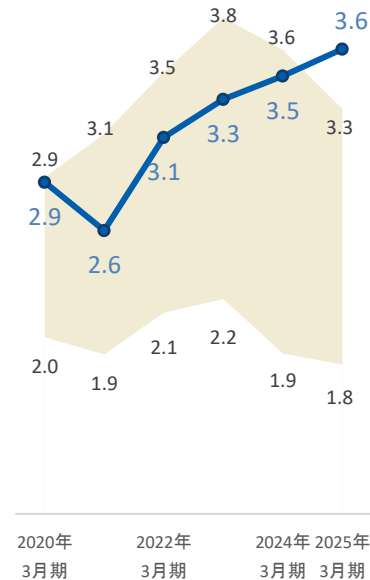
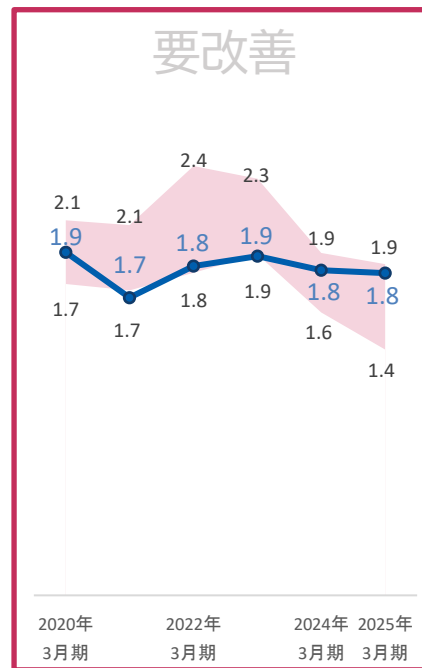
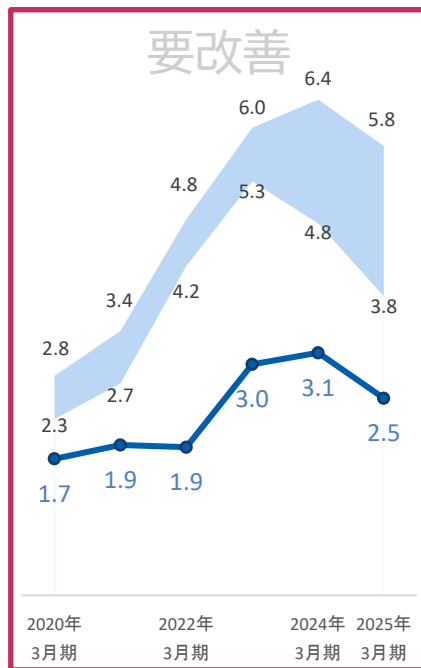
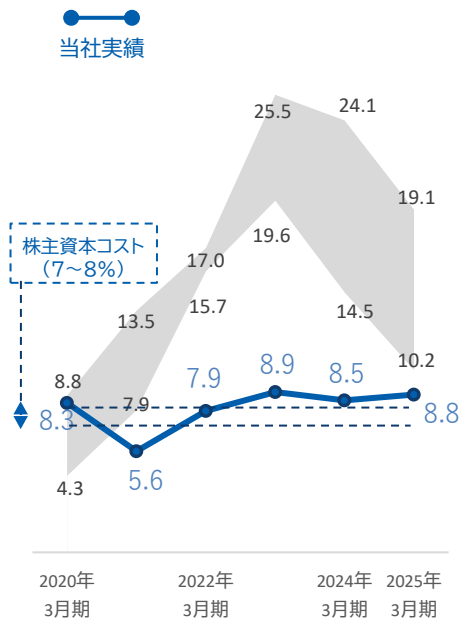


PBR1倍を超える水準はあるものの、概ね0.5～1倍水準で推移

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について【現状分析2】

ROE・デュポン分解で競合他社*1比較(色塗り部分は3社の最大値から最小値)による現状分析では収益性の改善が必須、また資産回転率も現状水準からの改善が必要

$$\text{ROE} = \text{収益性(営業利益)} \times \text{資産回転率} \times \text{財務レバレッジ}$$



*1競合他社：当社よりも時価総額が大きい上位3社

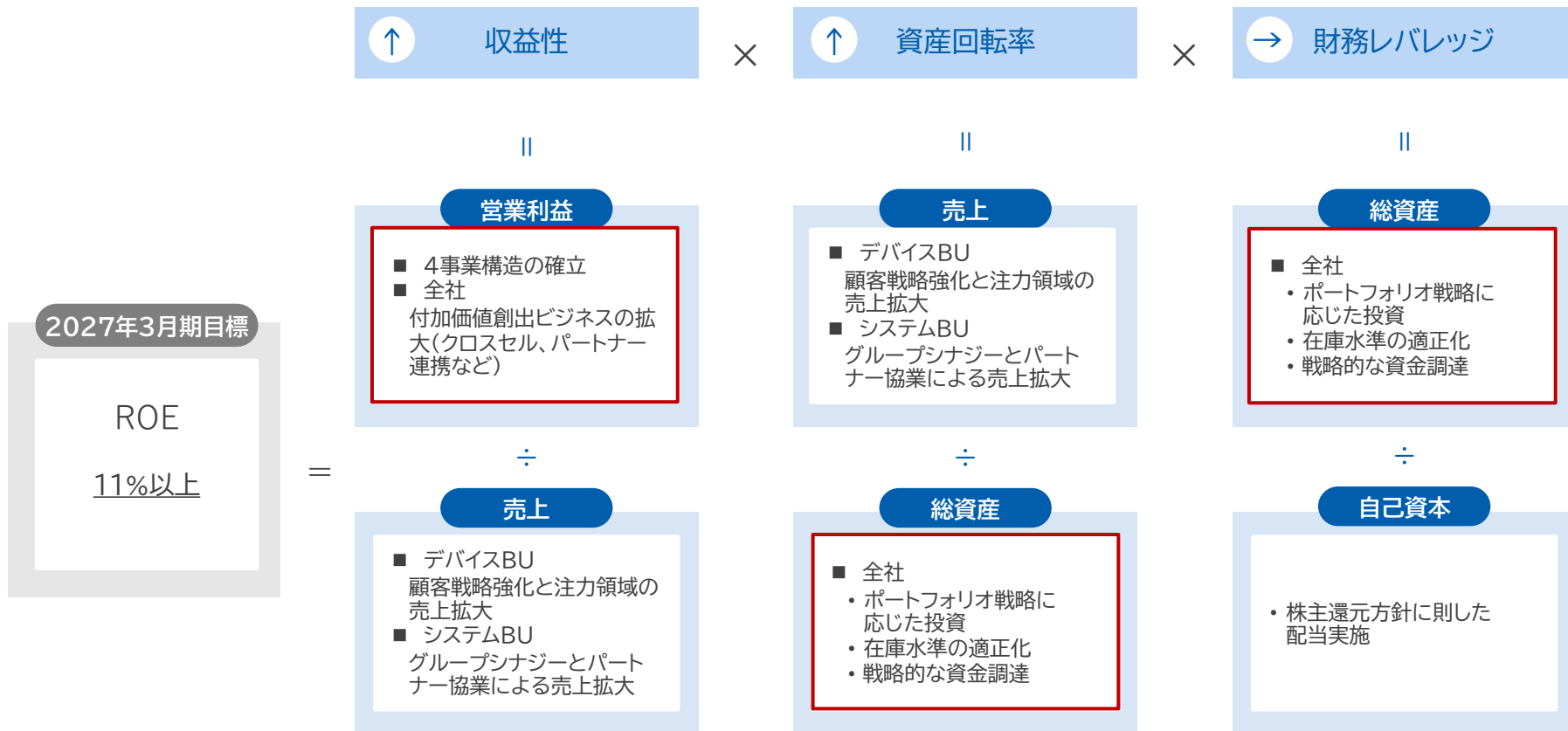
【財務規律の考え方】

ネットD/Eレシオ*2が安定的に1.2倍を下回る水準を維持

*2ネットD/Eレシオ=(リース債務を除く有利子負債-現金及び預金)÷自己資本

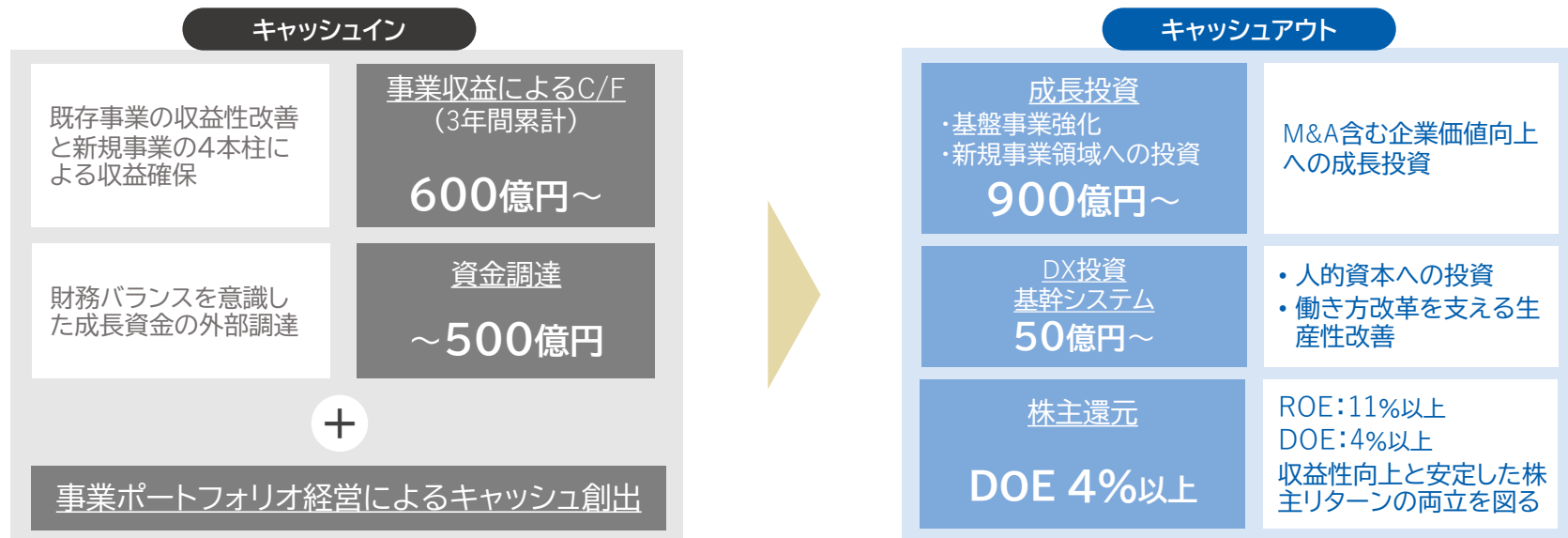
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について【目標】

収益性と資本効率の改善に取り組み、2027年3月期 ROE 11%以上を目標とする



キャッシュアロケーション(2027年3月期まで)

- 持続的成長によりキャッシュフローを創出し、財務バランスを意識しつつ事業拡大やM&A戦略を含む新たな成長投資と魅力ある株主還元を目指す



財務規律と資金調達

- ネットD/Eレシオの適正水準維持(=安定的に1.2倍を下回る水準)
- ハイブリッドローン(劣後特約付きローン)による借入や九州・沖縄地銀連携協定参加地銀からの資金調達
- 当社初めてとなる無担保普通社債の発行

3 デバイスBU／エンジニアリングBU

専務執行役員 柴田 真裕

- 顧客戦略と注力領域への施策実行による事業拡大と収益性改善

1. 顧客・仕入先別のアカウントプランニング強化

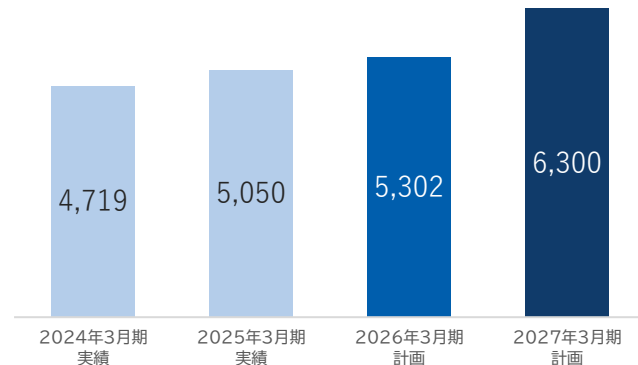
- 顧客基盤・商材・セールスネットワークの資産を強みとしたサプライチェーン強靱化による事業基盤の強化・拡大
- 戦略的パートナーシップによる付加価値創出と事業領域の拡大

2. 注力領域への施策実行

- 産機領域
 - マシンビジョン領域への注力(検査工程・品質管理など付加価値)
 - 戦略商材のFAE強化による収益性改善(センサー・FPGA・ARMツール・EPS・MMS等)
- 車載領域
 - 安全運転支援における戦略商材センサー領域を核としたクロスセル
 - 豊富なラインカードとFAEを生かした設計段階・上流工程での受注獲得
- グローバル展開
 - アメリカ、ヨーロッパ、ベトナム、インドへの販売拡大

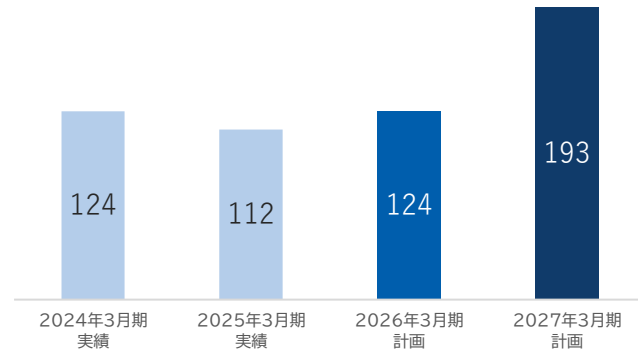
売上高

単位:億円



営業利益

単位:億円



デバイスBU進捗報告について

- ・ 合併会社設立や業務提携等によるパートナーとの連携強化により拡販を図る

01

デクセリアルズ(株)とのパートナーシップ形成

- A) 戦略的パートナーシップの形成
 - ・ ケミカル商材のラインカード拡充及びマーケティング強化
- B) 当社連結子会社としての販売オペレーション開始
 - ・ Restar Dexerials Hong Kong Limited(2024年7月1日)
 - ・ Restar Dexerials Korea Corporation(2025年1月2日)
 - ・ Restar Dexerials Taiwan Corporation(2025年2月3日)
- C) 連携強化
 - ・ アジアでの拡販
 - ・ 北米(デトロイト)を拠点とした車載関連ビジネスの拡大

Dexerials共創

FY25計画(売上高)

300億円超

02

WPGグループとの連携強化

- A) 顧客基盤の活用
 - ・ 当社製品の海外拡販及びWPG製品の日本国内販売
 - ・ クロスセルによる事業拡大
- B) 他BUとの連携
- C) マーケティング強化による事業創造

WPG共創

パートナー連携による
取り扱い商材の拡大
及び
規模拡大

03

新光商事(株)との業務提携による拡販

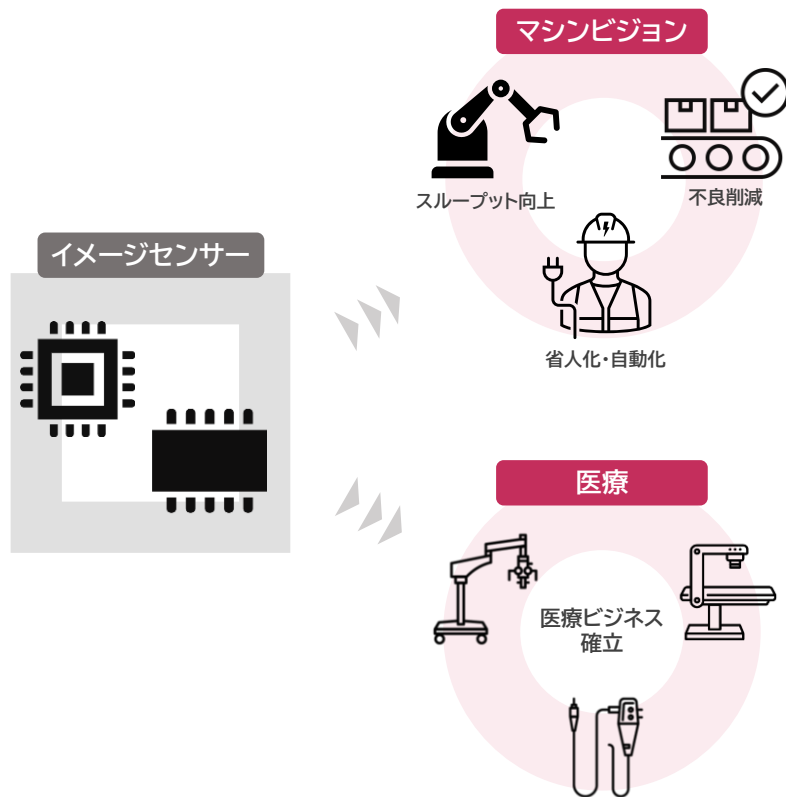
- A) 業務資本提携を活かした共創協業
 - ・ 両社の顧客基盤を活用した市場拡大と付加価値提供
 - ・ 注力領域である産機市場への拡販
- B) クロスセルによる既存事業の深耕
 - ・ 両社の顧客基盤を活かしたクロスセルの拡大



半導体商社としての競争力の向上

クロスセルによる
FY25からの
業績寄与

- イメージセンサーのマシンビジョンビジネス及び医療ビジネスへの展開



イメージセンサーの拡販



測定・計測分野

既存取引先へのTSS拡大とデザイン獲得率の向上



製造装置・検査装置・医療機器カメラ

潜在的TAMの大きな半導体製造装置及び検査装置メーカーや医療機器カメラへの拡販



MM(マスマーケット)顧客攻略

- ① 低シェア顧客の押し上げ、デザイン獲得、ラインカード拡充
- ② 効率的販促体制の構築(グループリソースの最適化)



海外市場への拡販

国内での実績をもとにグローバル市場への拡販を図る

- ・ FPGAによるデマンドクリエーションの実現を図り、当社グループの顧客基盤の活用により更なる拡販を図る

FPGAによるデマンドクリエーション

提案強化と顧客関係強化によるシェア拡大

注力アプリケーション



半導体製造装置関連



鉄道/交通関連

高付加価値市場でのマルチ提案強化

注力アプリケーション



航空関連



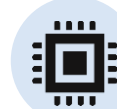
宇宙関連



防衛関連

新規市場／アプリケーション開拓

注力アプリケーション



半導体関連

- ・ ASICエミュレーション
- ・ SOMモジュール
- ・ SoC
- ・ ボードビジネス

グループ顧客基盤の活用により、更なるデマンドクリエーションの実現

ものづくり産業への需要創造

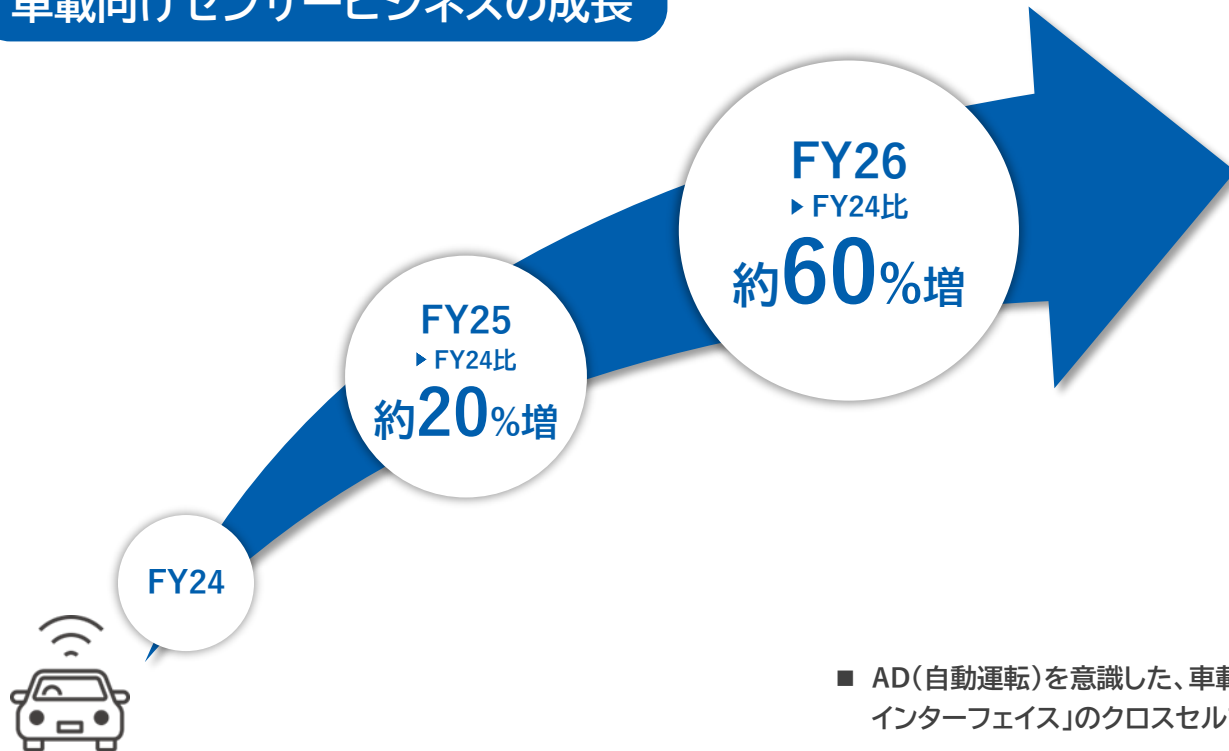
FY25計画(売上高)

150億円超

車載 ▶ センサービジネスの拡大による車載ビジネス基盤の拡充

- 競争力のあるラインカードを活かしたクロスセルによるソリューション展開を図り、車載ビジネス基盤を拡充

車載向けセンサービジネスの成長



- AD(自動運転)を意識した、車載向けセンサーを軸に「センサー+ビデオインターフェイス」のクロスセルで拡販強化・シェア拡大

グローバル▶商材活用によるマーケット拡大

- ・ 合併会社設立や業務提携等によるパートナーとの連携強化により拡販を図る

パートナー連携による欧米向け重点施策

① イメージセンサービジネスの拡販

- ・ 欧州市場での基幹ビジネスとして育成し、市場シェアを拡大

② 車載向け半導体ビジネスの売上拡大

- ・ 安全運転支援をさせるセンサー商材を中心

③ 車載向けケミカル商材ビジネスの本格的立上げ

- ・ Dexerialsとの連携により、車載向けケミカル商材ビジネスの本格的立ち上げへ

既存パートナー
との更なる
連携強化

インド市場への進出

パートナー連携を基盤としたインド市場開拓

- ① パートナー連携によるカントリー・リスク軽減、成長市場への展開
- ② インド全地域にて産機を中心に、幅広い市場セグメントをカバー
- ③ 顧客密着型営業体制：
「営業」と「FAE」が一体となり顧客密着にて機動
- ④ 当社取り扱い商材とパートナー取り扱い商材のクロスセルを実現し、更なるラインカードの拡充を図る

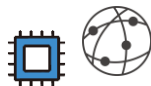
FY25より
施策の具現化

- FPT Semiconductor社(以下「FPT」)と半導体販売や共同研究・設計開発等、半導体関連分野において更なる協力関係を推進することを目的とし、2025年4月28日に開催された日越首脳会談において基本合意書を締結
- 今後、確立を目指すエンジニアリングBUとの連携を図る

デバイスBU

01

半導体チップの販売



- ✓ FPTが設計・製造した半導体チップを当社とFPTそれぞれのネットワークとリソースを活用した販売促進及び市場開拓

販売目標: **1,000万個**
(FY25-FY27)

エンジニアリングBU

02

半導体の共同研究・設計開発



- ✓ 半導体製品に関する共同研究及び設計開発プロジェクトの立ち上げ
- ✓ 技術力の相互補完による競争力のある製品開発を目指す

03

半導体のテスト、OSAT*事業



- ✓ 半導体のテスト及びOSATについて、連携した提供体制を構築し、顧客への品質保証及び安定供給に取り組む

*OSAT:後工程サービス

04

オフショア開発の推進



- ✓ FPTが保有するベトナムを中心としたオフショア開発体制を活用
- ✓ 顧客に対して設計・検証・開発等のエンジニアリングサービスを提供

デバイスBUとの連携

当社顧客基盤を
活かした拡販

エンジニアリングBU確立に向けて

1. PCIホールディングス株式会社の子会社で、電子回路・制御ソフトウェア開発や半導体テスト関連サービスを行う株式会社プリバテックと連携、半導体の共同研究、設計開発を強化
2. 当社の半導体信頼性評価センター(熊本拠点)やFPTとの協力による信頼性試験などの半導体テストの強化

産業機器市場

FY24 → FY25(売上高)

約**20%**増

1. イメージセンサー

- ・マシンビジョン・医療ビジネスへ展開
- ・グローバル市場への拡販

2. FPGA

- ・ものづくり産業でのデマンドクリエーション
- ・当社グループの顧客基盤の活用による拡販

3. 新光商事

- ・資本業務提携を活かした共創協業の拡大
- ・マスマーケット市場のビジネス拡大

車載市場

FY24 → FY25(売上高)

約**10%**増

1. 車載ビジネス基盤の拡充

- ・クロスセルによるソリューション展開
- ・センサービジネスに加え、ディスプレイ拡販
- ・グローバル市場への拡販

2. 競争力のあるラインカードの活用

- ・センサービジネスの拡販
- ・海外メーカーの車載ディスプレイ拡販

3. 新光商事

- ・両社の顧客基盤を活かしたクロスセルの拡大

グローバル市場

FY24 → FY25(売上高)

約**25%**増

1. パートナーとの連携強化による市場拡大

- ・欧州:イメージセンサーを活用した車載ビジネスの拡大
- ・米国:ケミカル商材を活用した車載ビジネスの立ち上げ
- ・インド:イメージセンサーを活用した産機市場への参入

2. FPT連携

- ・FPT商材の拡販
- ・共同研究・設計開発等、更なる協力関係強化
- ・信頼性テストの協業
- ・エンジニアリングBU確立に向けた連携

- ・ 半導体開発や製造メーカー及びハードウェア開発や製造メーカーを顧客として技術を事業として提供
- ・ 技術者の育成を行い、デバイスBUと共に持続的な事業成長を目指す

事業環境

外部

- ・ 国内の半導体製造関連事業活性化、他方で国内半導体メーカーの弱体化
- ・ エンジニア人材プールの不足（ハード、ソフト/セット、半導体）
- ・ 少子高齢化に伴う構造課題

内部

- ・ リソースの分散による非効率性
- ・ 既存顧客向け事業の縮小
- ・ メーカーの設計開発アウトソーシングのストラクチャー変化
- ・ エンジニアキャリアパス形成不足、スキルを有する人材の不足

方向性

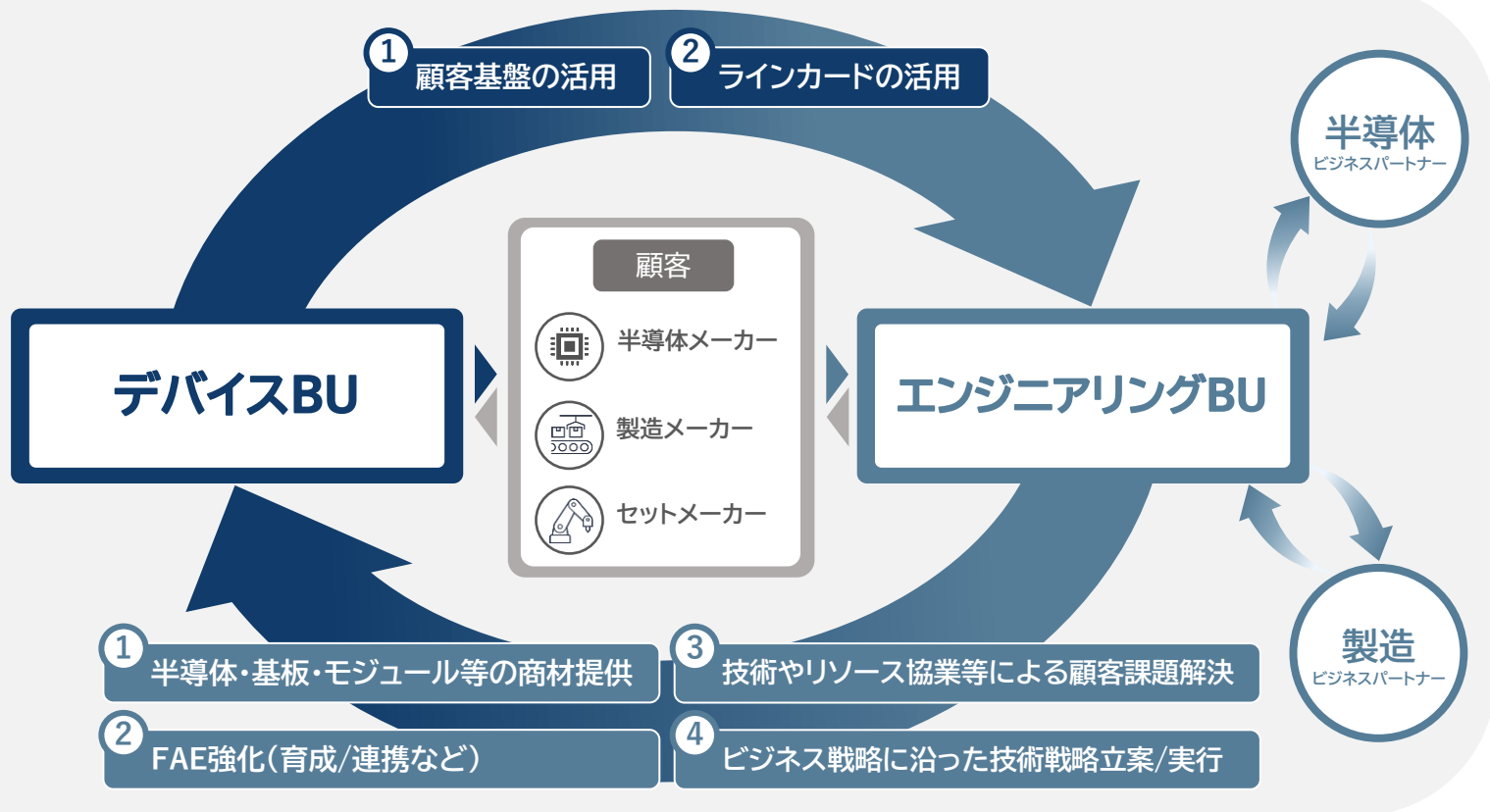
目指す姿

- ① 自社での半導体開発を目的地に付加価値が高い開発、製造業務の受託事業の運営（顧客は半導体開発、製造メーカー、セットメーカーを想定）
- ② レスターのデバイス事業に密接に寄りそう技術センターとして技術者の輩出及び技術戦略の立案・実行

エンジニアリングBU戦略

- 1 半導体開発、ハードウェア開発、製造メーカーを顧客と定義・創造
- 2 高付加価値事業領域の創出・拡大
- 3 1、2 を実現する手段としてパートナー連携及びM&A
- 4 技術者の育成、管理、制度設計を通じ、技術を事業競争力のコアへ

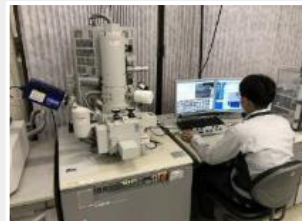
- 高付加価値な受託事業で持続的に顧客に貢献するとともにデバイスBUを支えるグローバルなエンジニアリング集団となる



- 国内4拠点で<信頼性試験受託サービス>を提供

事業内容	主要製品
信頼性試験受託サービス	信頼性試験受託サービス・バーンインボード設計/製作・電子部品解析/分析サービス
工程請負サービス	量産バーンイン請負サービス・各種治具類設計製作

信頼性試験の様子



<試験条件> + <試験サンプル> に合わせ、装置を選定のうえ試験実施

1

各種信頼性試験



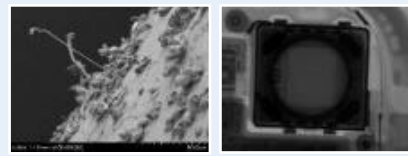
3

ESD/LU試験



5

解析・観察



2

強度試験



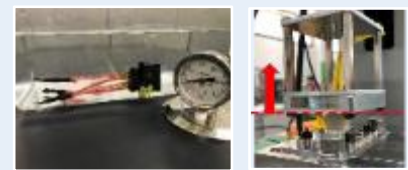
4

試験用ジグ作製



6

カスタム試験



- ・ 設計～試作～評価/テスト～量産までカバーする設計サービス
- ・ ファームウェア・ドライバ～アプリケーションまで幅広く対応

02

ボード開発

- 基板/モジュール開発
- 回路設計・FPGA開発
(アナログ/デジタル)
- 実機評価/測定/解析
- デバイス技術サポート

01

半導体開発

- LSI開発
- LSIテストプログラム
- 評価、測定、選別、量産
- テスタレンタル
- ツール販売

03

ソフトウェア開発

- 組込みソフトウェア
- アプリケーションソフト
- デバイスドライバ
- ファームウェア

04

システムソリューション

- IoTセンサープラットフォーム
- センシングシステム開発
- ディープラーニングカメラ
スターターキット
- OEM/ODM

4 システムBU

代表取締役専務 今野 宏晃

システムBU▶重点施策／成長戦略

- ・ GXとDX、そしてグループシナジーとパートナー協業を活かした事業拡大

1. グループシナジーを活かした付加価値の拡大

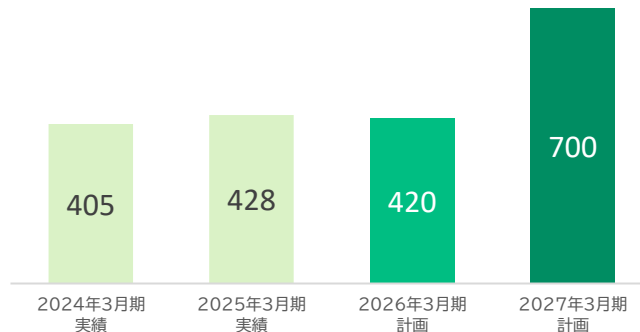
- グループ顧客基盤の活用による事業拡大・強化
- グループの各種サービスシステムの横断的保守サポート体制の確立
- 保守ビジネスの外販強化とサービス範囲の拡大
- エネルギー地産地消モデルの更なる展開

2. 注力領域への施策実行

- 法人向け事業
 - ・ オフィス関連ビジネスの拡大
 - ・ リテール業界向けのビジネス拡大
 - ・ スtock型ビジネス構築と関連するシステム運用やコンテンツなど付加価値提供
- 公共向け事業(自治体・教育・医療・防衛)
 - ・ 省人化に資するDXモデルの開発・提供
 - ・ 再生可能エネルギーのシステム開発・提供による地域GXの推進
 - ・ パートナーとの協業を通じた地域創生の事業深耕と開発

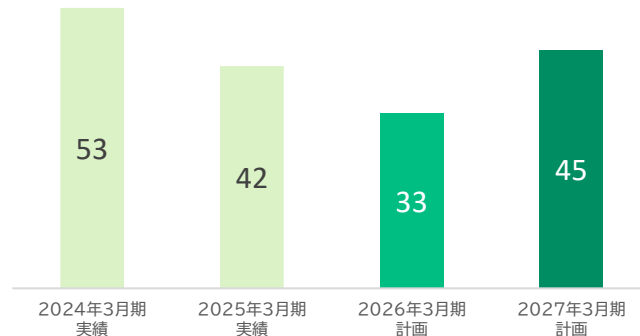
売上高

単位:億円



営業利益

単位:億円



- ・リテール業界のDXの推進を背景に、ストック型ビジネスの立上げ実施
- ・ストック型ビジネス構築と関連するシステム運用やコンテンツなど付加価値提供

実績

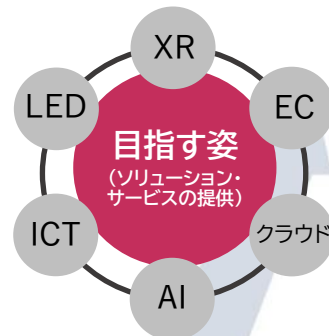
- ① 企業のオフィス移転が活発化
 - ・移転ビジネスにて売上好調を維持
 - ・効率的な移転サービス等を提供を推進
 - ・顧客の成長と発展を支援
- ② スtock型ビジネスの立上げ
 - ・商業施設への“スタッフサインージ”の導入
- ③ 戦略パートナーとの連携強化

今後の取り組み

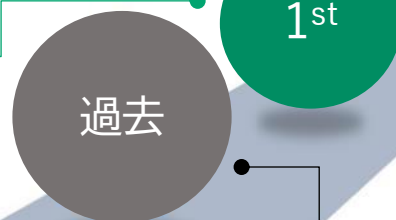
- ① 動画配信サービス事業者へのサービス提供の検討
- ② イベントにおけるレンタル事業の新規施策及び規模拡大
- ③ AVシステムを活用したデジタル広告ネットワーク事業への新たなサービス提供→次項にて説明

■ サービス運営

- ・バーチャルプロダクション
- ・施設運営・運営支援
- ・レンタルサービス
- ・イベント支援



24年度～25年度



コンテンツ
制作・運用

単品販売
映像・音響システム

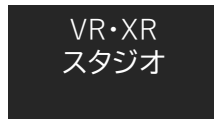
レンタル事業

「レンタル」と「保守・運営」機能を融合

イベントのサービス運営(配信・運用・レンタル)を充実し
事業領域の更なる拡大へ

レンタル

事業 機材の長期・スポットレンタル
顧客 映像制作会社・イベント会社
市況 イベントのレンタルサービスが好調



事業 機材・システムの運用サポート
顧客 企業・文教・常駐保守
市況 イベントの配信・運用サポートが好調

保守・運営

ストック型ビジネスの構築

広告・看板デジタルサイネージの運営事業へ参入

新たな事業参画におけるストック型ビジネスの構築へ

広告・看板をデジタルサイネージ化

1st STEP 既存ビジョン事業の拡大

紙からデジタルへ転換により媒体価値向上

- 情報量の増加 静止画から動画へ
- 視覚的な訴求力向上
- 柔軟な広告配信 状況に応じた即時変更
- コスト削減 印刷・設置工数減

広告・看板デジタルサイネージの運営事業への参入検討

2nd STEP ストック型ビジネスへのチャレンジ 街中のシンボリック看板をサイネージ化へ

レスター

- 既存ビジョン事業の拡大
- 定期収益の獲得
- 物品取引以上の価値提供



お客様

- 一等地での動的広告
- 仕入先: LED商材の宣伝
- 顧客: 効果的な宣伝活動

- ・ 脱炭素化エネルギーの推進を背景としたオンサイトPPA事業の拡大
- ・ 蓄電池への投資による需給調整市場における競争力強化

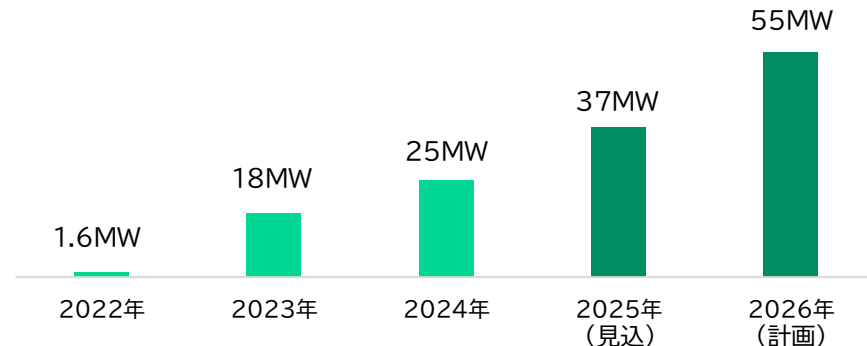
実績

- ① **PPAの展開・加速**: グループシナジーを活かした顧客の脱炭素支援
 ➡ 再生可能エネルギー促進による環境負荷及びコスト削減
- ② **電力の小売における売上拡大**: 調達リスク対策や電力市場の柔軟な活用

今後の取り組み

- ① 既存太陽光発電所におけるリパワリングの促進
- ② 系統用蓄電所への投資: 需給調整市場における競争力強化
- ③ オフサイトPPA事業の拡大
- ④ 新たなPPAモデルの確立: 営農型太陽光発電所を活用した食とエネルギーの地産地消
- ⑤ アグリゲータービジネスへの参入

● PPA事業計画



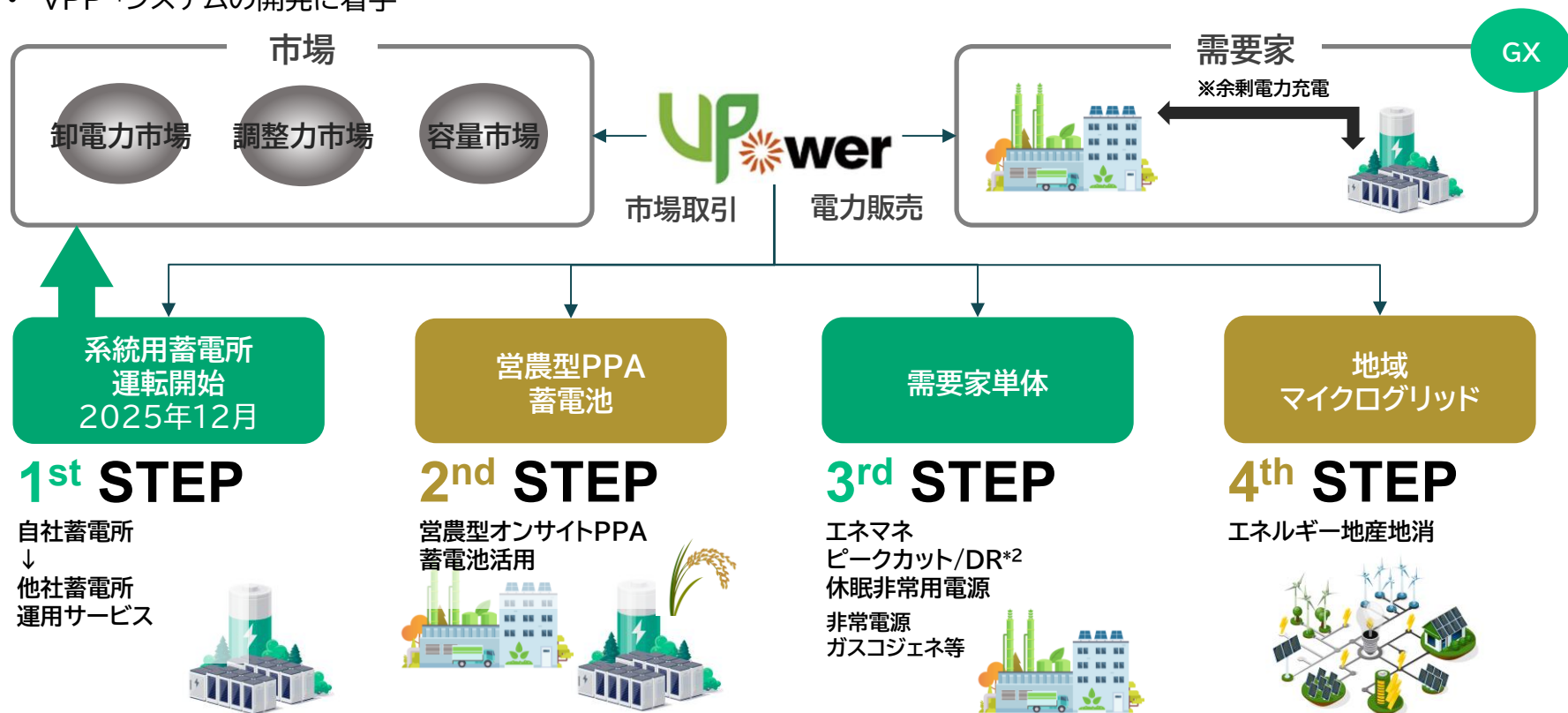
● 蓄電池を活用した事業モデル



事業計画(時期、規模の確認)

1st	系統用蓄電所の設置
2nd	PPA+蓄電池
3rd	需要家エネマネ
4th	地域マイクログリッド

- ・ 系統用蓄電所の運営開始を皮切りにアグリゲーターライセンス認証
- ・ VPP*1システムの開発に着手



*1 VPP: Virtual Power Plant

*2 DR: Demand Response

5 IT&SIerBU

PCIホールディングス株式会社
取締役 森下 健作

- PCIグループを中核とする「IT & SIerBU」の立上げ、強化
- 1,000名超の豊富なエンジニアリングリソースを有効活用した新たなビジネススタイルを推進

事業環境

外部

- 生成AIによりIT業界のビジネスモデルに大きな変化
- DX需要の拡大
- 国際情勢・金融情勢等による物価・人件費高騰
- 国内労働力人口の減少

内部

- AIの徹底活用
- PCIグループのレスタグループインによる経営基盤強化
- 高付加価値ソリューションのセールス及びデリバリー体制の確立
- 買収・資本業務提携による事業の拡大・多角化

方向性

目指す姿

自動車・電気機械・精密機械をはじめとした製造業に特に強い
高付加価値ソリューションプロバイダー

IT & SIerBU 戦略

1 営業力の強化

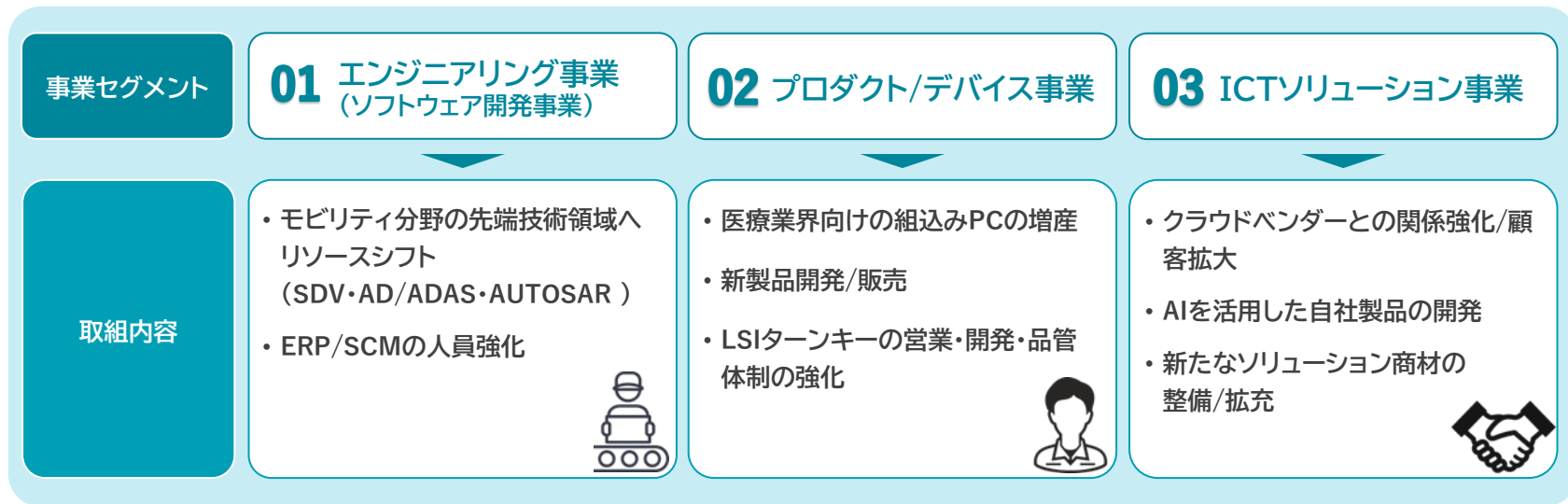
- 7,000社超のデバイスBU/システムBU顧客の経営層・企画部門へアプローチするハイタッチセールス体制を確立

2 技術力の強化

- 総合技術コンサルティング企業へ進化すべく顧客へ企画立案から実践まで伴走できるデリバリー体制
- AI技術活用をはじめとした最先端ソリューション開発体制を確立

3 オペレーション力の強化

- 対話型生成AIを全従業員が安全・安心に積極的に活用する環境整備等により生産性を向上し、企画・戦略・実践を高速実行できる体制を確立



より収益性の高い分野・顧客へシフトし、高収益事業として更に稼ぐ力を強化

既存BUとのシナジー創出により更なる事業拡大を図る

- ・ 強固な経営基盤、優良な顧客基盤を有する当社との連携により、中期経営計画の目標達成を深化、加速を図る

① 市場の深化/拡大による製造業向けビジネスの拡大

- ・ 両社が強みを有する「車載」「産機」「ICT」等の市場の深掘り
- ・ 相互補完可能な市場(海外、民生、建機、セキュリティ等)の捕捉
- ・ 当社の優良顧客基盤へのアプローチ等によるビジネスの拡大

③ 企画提案力強化によるSIer上流プロセスへの展開

- ①、②の実現により、
- ・ 両社のハードウェア/ソフトウェアのソリューション提案力向上
 - ・ 顧客への直接的なビジネス機会の増加を通じて、当社による企画提案等の上流プロセスへの展開の加速

② 技術リソースの質・量の拡充

当社グループ技術者の活用による

- ・ 当社の既存ビジネスの規模、及び技術領域(システム構築、AI、画像処理、通信等)の拡大

④ 経営基盤の強化とスケールメリット

- ・ 当社の強固な財務基盤を背景とした事業の拡大
➡ 運転資本増強、成長投資の拡大
- ・ スケールメリットに基づくコストの削減・圧縮

- IT & SIerBUの中核として当社の顧客基盤に対する提案活動を実施中

- 顧客に提供する付加価値の源泉としてPCIグループの技術力を活用
- フック商材としては以下を活用
 - 当社のエンジニアリングサービス
 - AI(画像系、生成系)
 - セキュリティ(診断・調査・コンサルティング等)

顧客基盤の活用

- レスターの顧客基盤7000社に対して
- 顧客の課題を引き出す・設定する能力が必須
- 売り先(会う人)の変化が必須

乗り越えなければいけない壁

Restar 製品群ポートフォリオ		市場	キーパーソン(売り先)										バリュー	規模	ビジネス	利益率
			経営	企画	経理	人事	IT	製造	品質	生産	開発	購買				
デバイスBU	エレクトロニクス商材 センサー・マイコン・リレー、 コネクタ、スイッチ、電源、 電子部品、ケミカル材	製造業	-	-	-	-	-	○	○	◎			品揃え デリバリー			
エンジニアリングBU	半導体設計・開発 解析・各種IP/ソフト ターンキーサービス 信頼性試験受託	車載 産業機器 民生・OA他	-	○	-	-	-	○	◎	○			技術力 ターンキー			
システムBU	電子機器、再エネ、設置・ 施工・保守	地方自治体 放送・通信 産学・文教・ 医療、他	○	○	○	○	◎	-	-	-			オーダーメイド カスタム 組み合わせ			
IT & SIerBU	AI、セキュリティ、IoT、クラ ウド、SaaS、研修、コンサル ティング、エンジニア派遣	全業種	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	技術力 ソリューション コンサルティング			

- シナジーにより新たな案件/領域に向けた、以下のような受注を獲得(一部商談中)

総合家電メーカー	クラウド型調達・購買システムを使用した間接材購買管理案件
漁業組合	基幹システムのDX化、及びセキュリティ強化のためのシステムコンサル提案
産業機器メーカー	映像セキュリティシステム用PC開発
精密機器メーカー	ATM用組込みコンピューター開発/Linuxコンサル提案

エレクトロニクスに関する世界中の課題を解決する。

